

2024年3月期 第1四半期
決算説明資料

上村工業株式会社

東京証券取引所スタンダード市場 証券コード：4966

2023年8月9日

【連結会計期間】

日本国内(2社)：4月～6月／海外(10社)：1月～3月

● 表面処理用資材事業

- 主力のパッケージ基板向けのめっき薬品は、前年後半から続いているデータセンター向けサーバー市場における投資抑制とパソコンやスマートフォンの販売台数の落ち込みによる在庫調整の影響を受けて、売上高、セグメント利益ともに前年同四半期を下回りました。

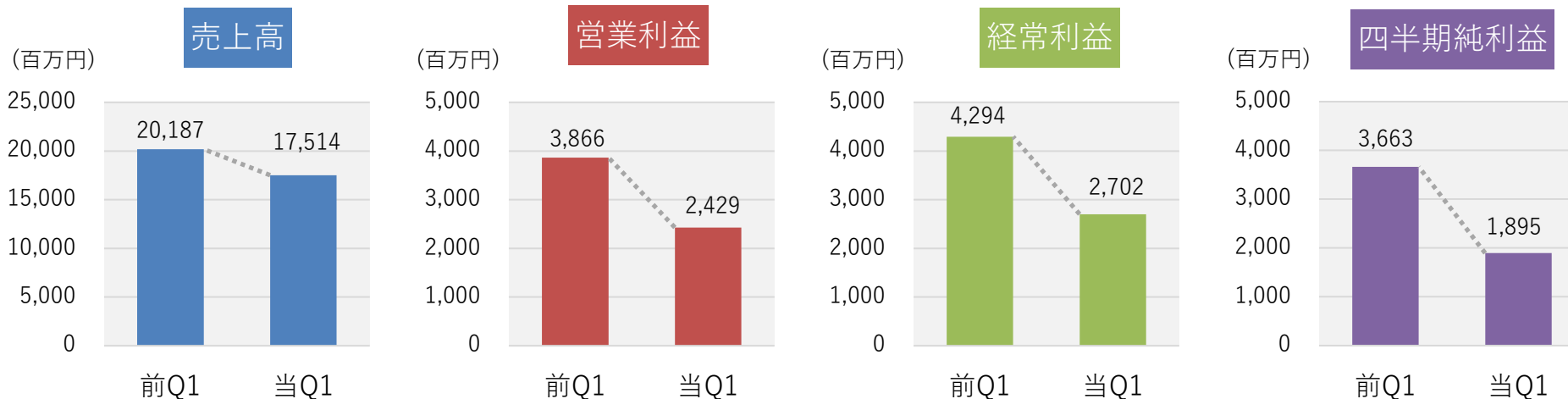
● 表面処理用機械事業

- 日本国内において車載用パワーデバイスの製造に使われる半導体ウェハー向けのめっき用装置の販売が増加し、売上高、セグメント利益ともに前年同四半期を上回りました。

● めっき加工事業

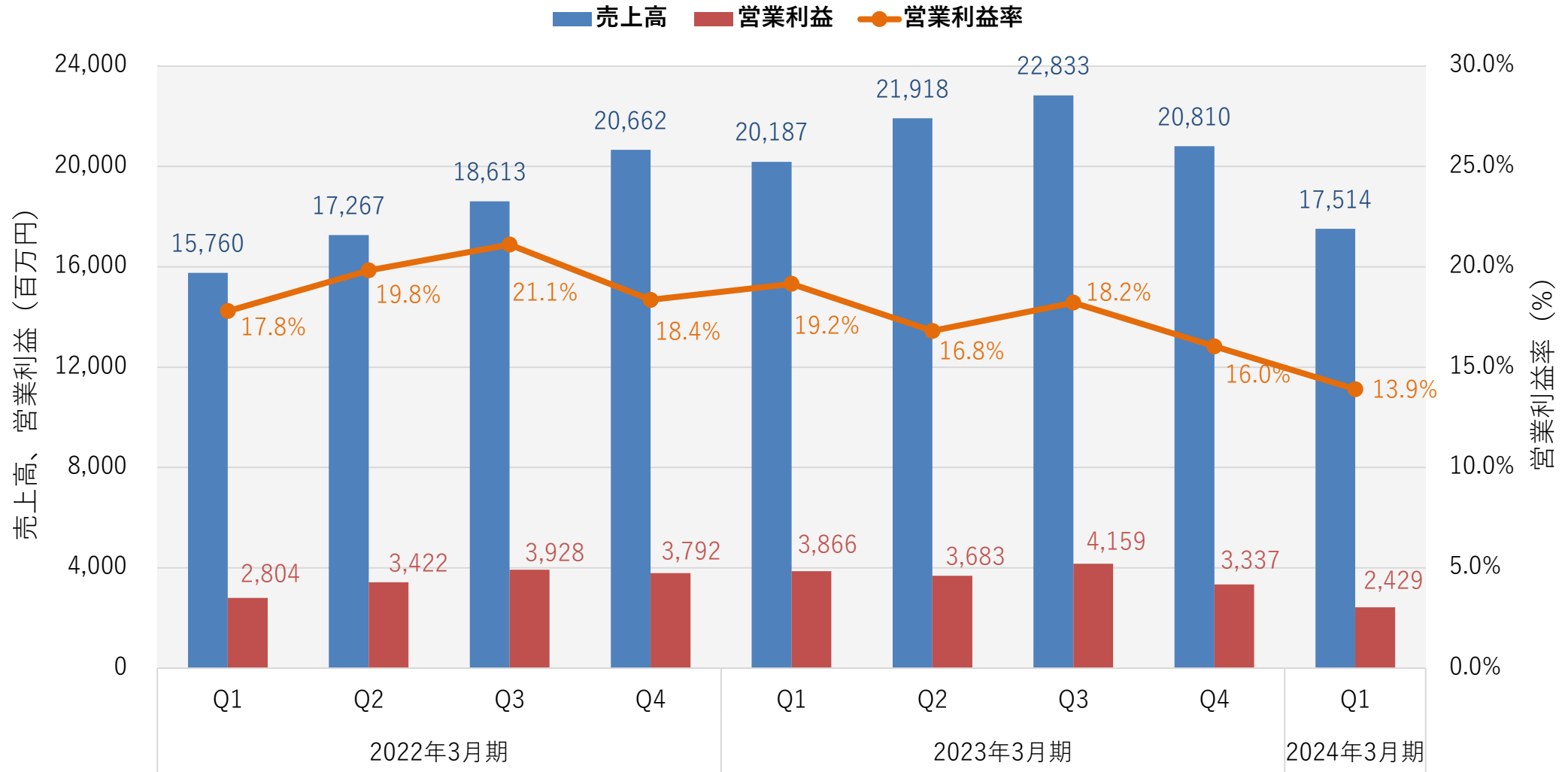
- タイやインドネシアにおける自動車産業は、急速な電動車の普及や塗装された部品の採用拡大により、プラスチックへのめっき加工の需要が低迷し、売上高、セグメント利益ともに前年同四半期を下回りました。

2024年3月期 第1四半期 決算概要



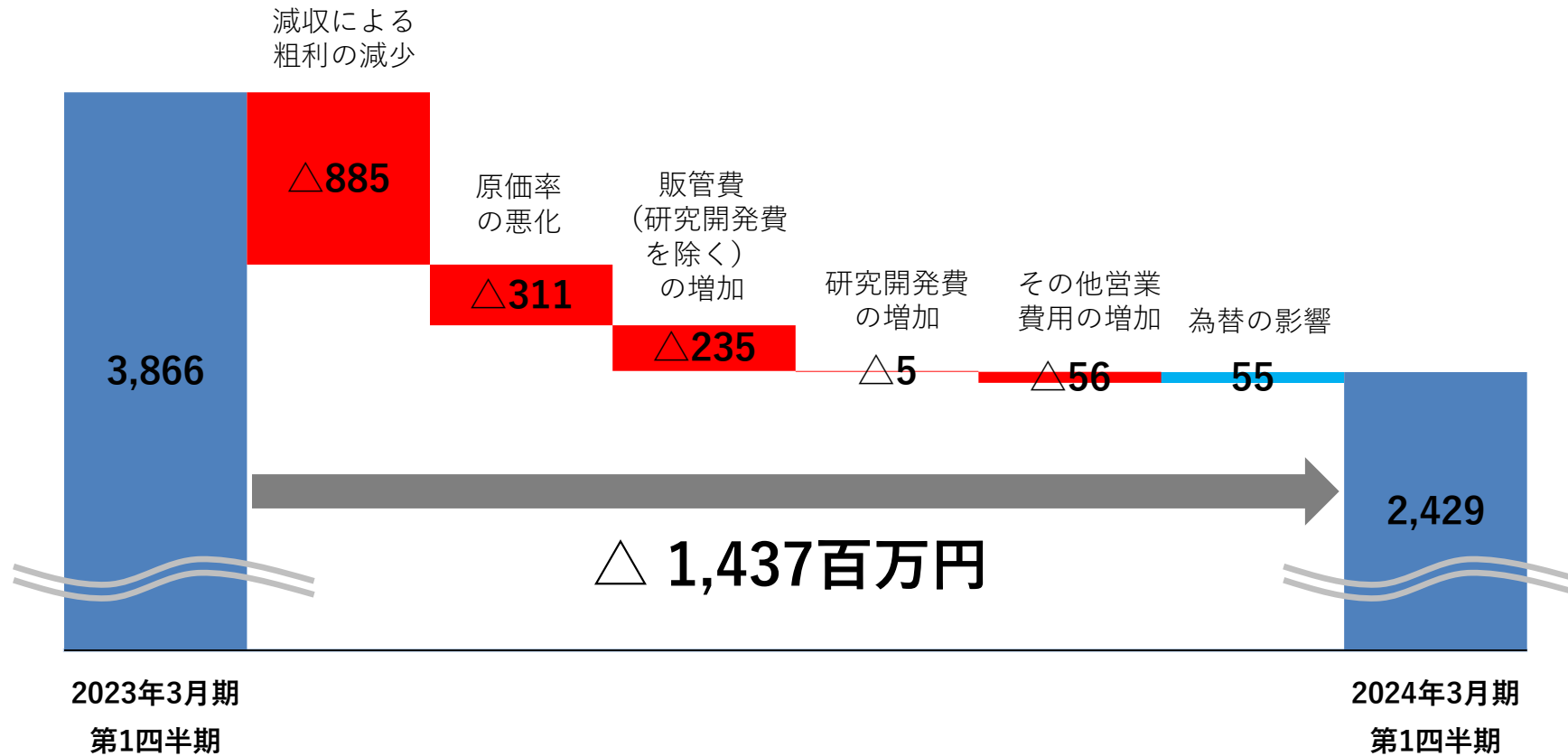
(単位：百万円)	前第1四半期 累計実績	当第1四半期 累計実績	増減額	増減率
売上高	20,187	17,514	△ 2,673	△ 13.2%
営業利益	3,866	2,429	△ 1,437	△ 37.2%
経常利益	4,294	2,702	△ 1,592	△ 37.1%
四半期純利益	3,663	1,895	△ 1,768	△ 48.2%
為替：米ドル	116.34円	132.42円	16.08円安	

四半期毎の業績推移

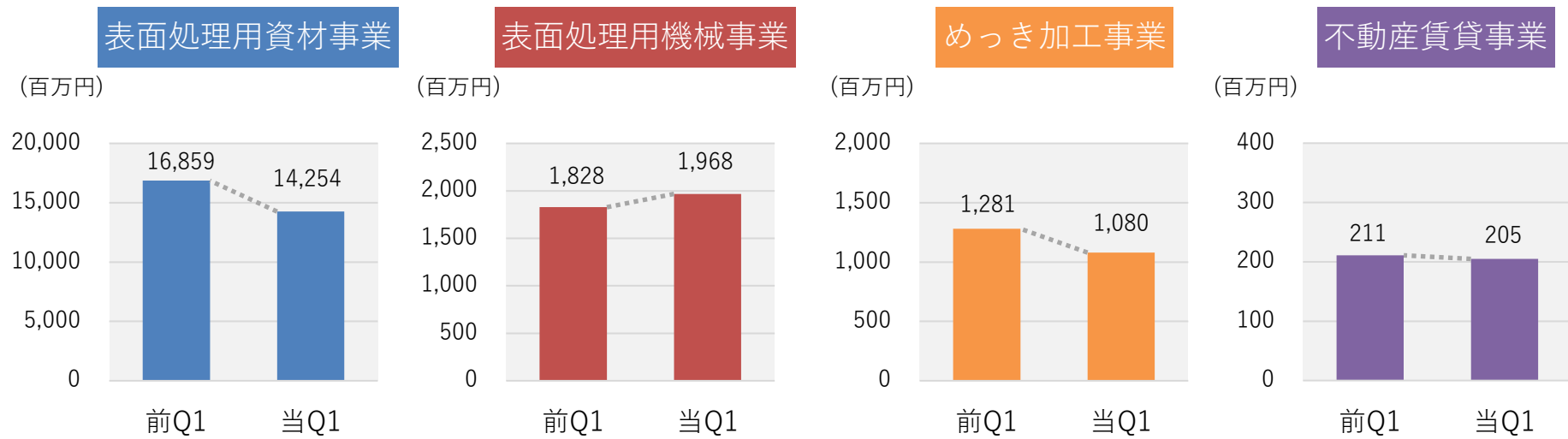


営業利益の増減要因

(単位：百万円)



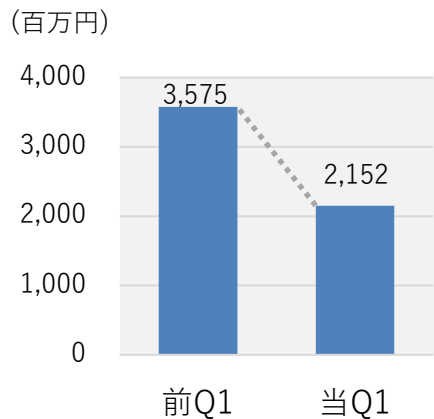
事業セグメント別売上高



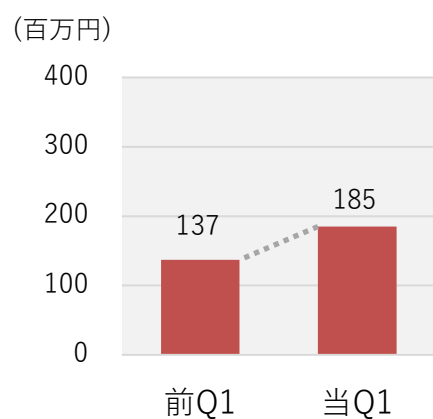
(単位：百万円)	前第1四半期 累計実績	当第1四半期 累計実績	増減額	増減率
表面処理用資材	16,859	14,254	△ 2,605	△ 15.5%
表面処理用機械	1,828	1,968	+ 140	+ 7.6%
めっき加工	1,281	1,080	△ 201	△ 15.7%
不動産賃貸	211	205	△ 6	△ 2.8%

事業セグメント別営業利益

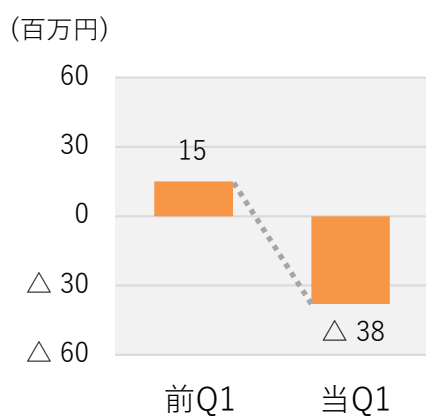
表面処理用資材事業



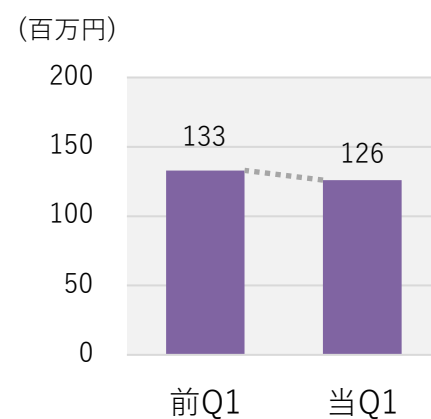
表面処理用機械事業



めっき加工事業

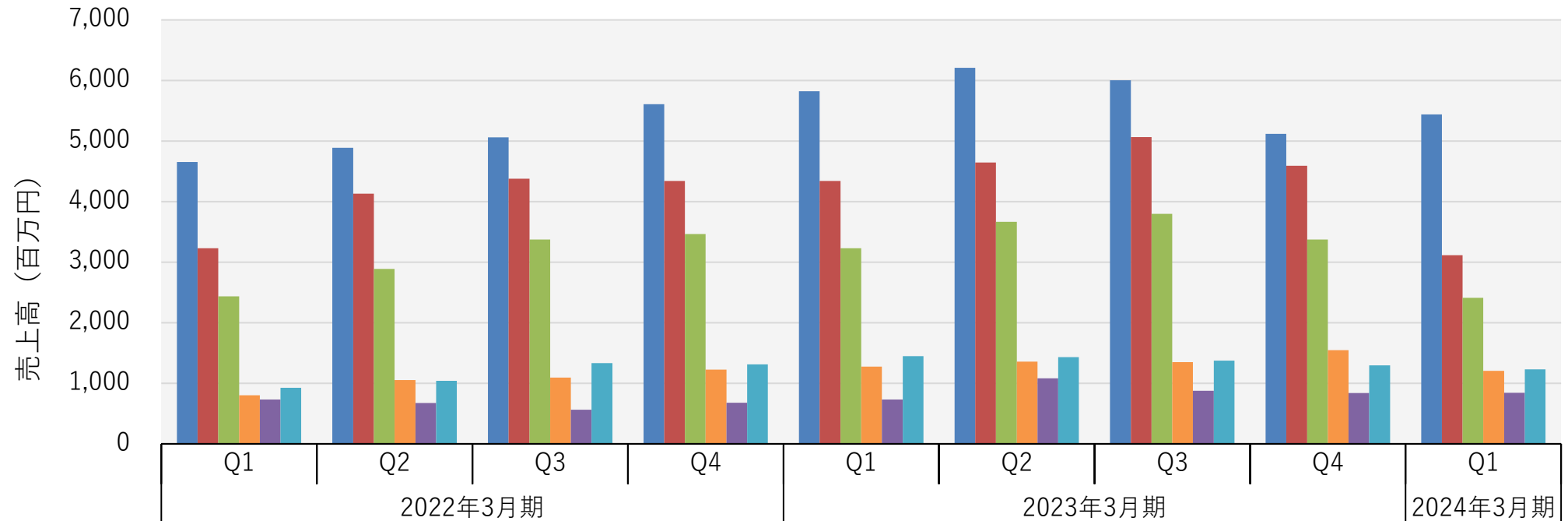


不動産賃貸事業



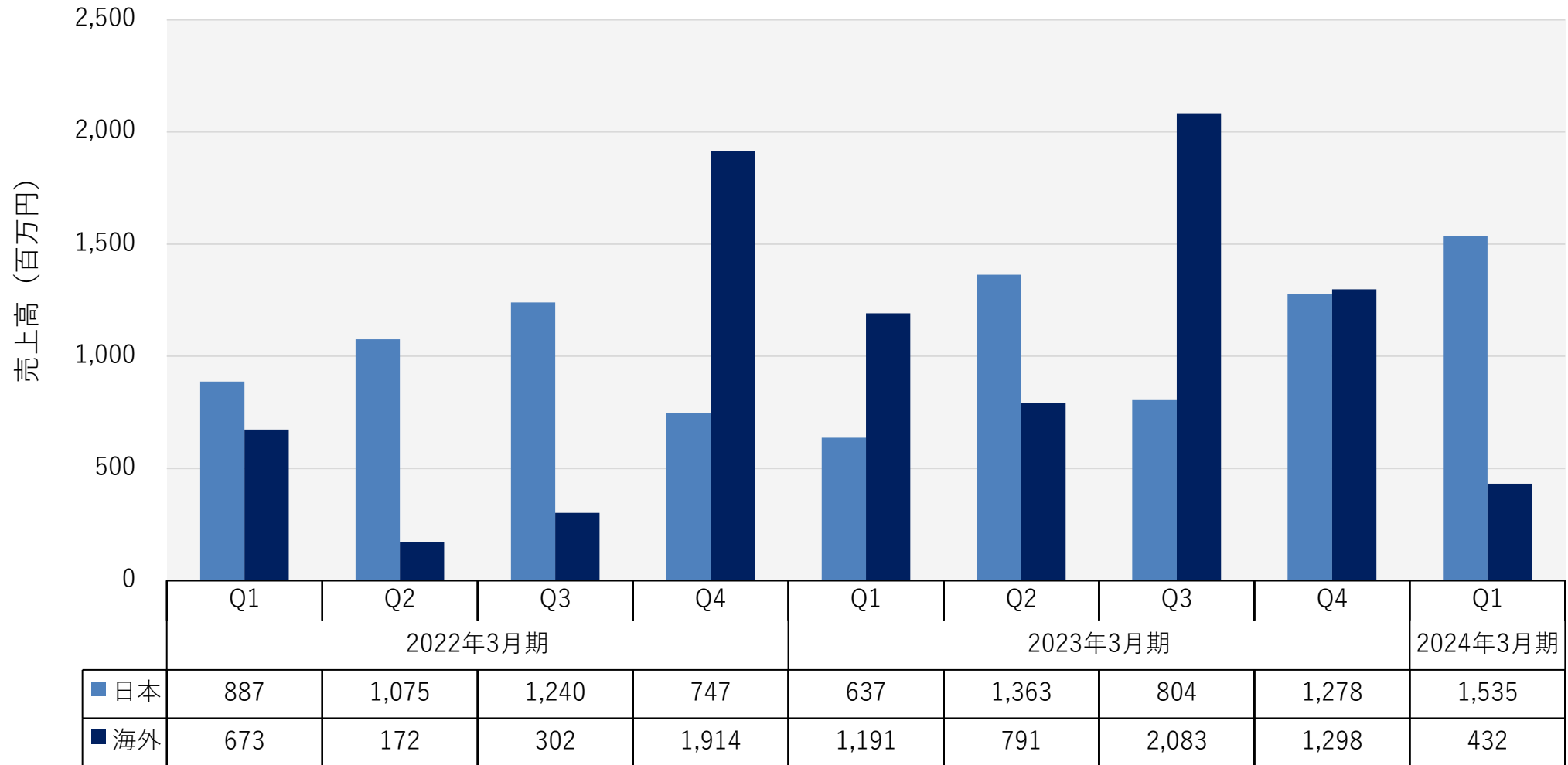
(単位：百万円)	前第1四半期 累計実績	当第1四半期 累計実績	増減額	増減率
表面処理用資材	3,575	2,152	△ 1,423	△ 39.8%
表面処理用機械	137	185	+ 48	+ 34.7%
めっき加工	15	△ 38	△ 53	-
不動産賃貸	133	126	△ 7	△ 5.3%

表面处理用資材事業 売上高推移

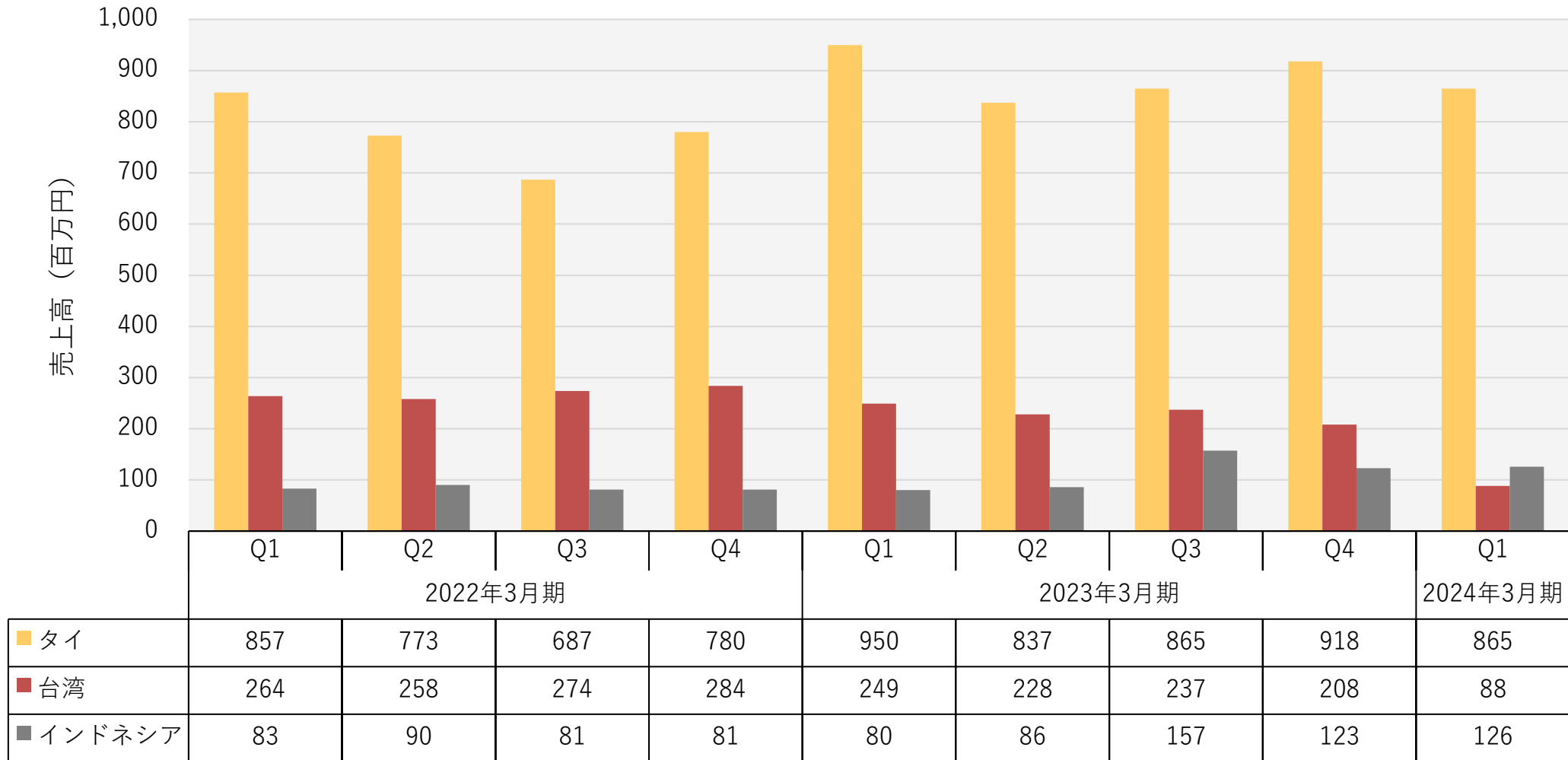


	2022年3月期				2023年3月期				2024年3月期
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
■ 日本	4,653	4,889	5,062	5,608	5,823	6,209	6,005	5,117	5,440
■ 台湾	3,231	4,133	4,380	4,343	4,341	4,644	5,065	4,591	3,117
■ 中国	2,436	2,887	3,375	3,465	3,232	3,666	3,797	3,376	2,413
■ 韓国	803	1,054	1,096	1,227	1,277	1,358	1,348	1,546	1,207
■ A S E A N	733	675	564	681	734	1,083	875	838	845
■ 北米	924	1,040	1,333	1,314	1,450	1,431	1,376	1,296	1,229

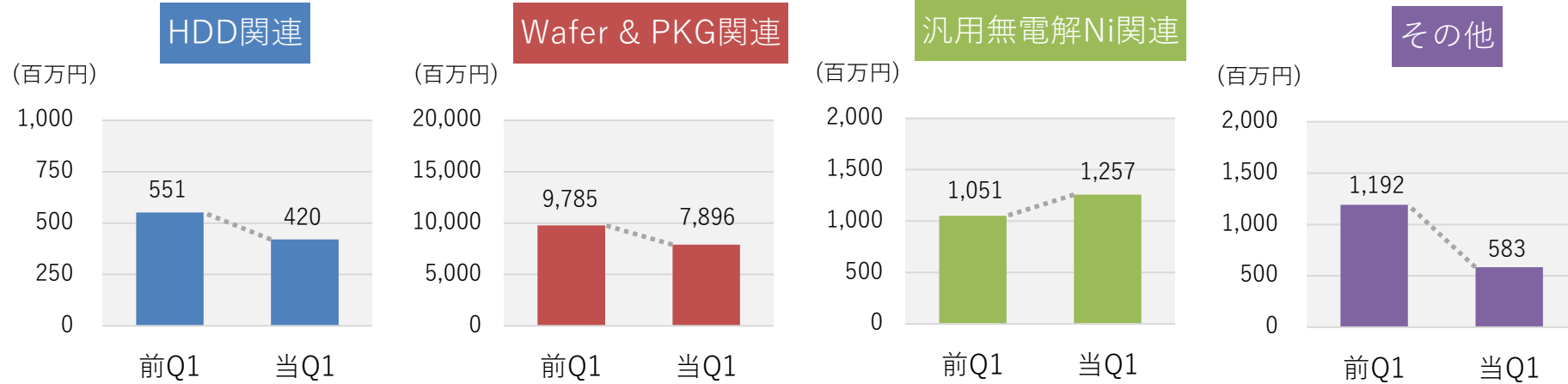
表面处理用機械事業 売上高推移



めっき加工事業 売上高推移



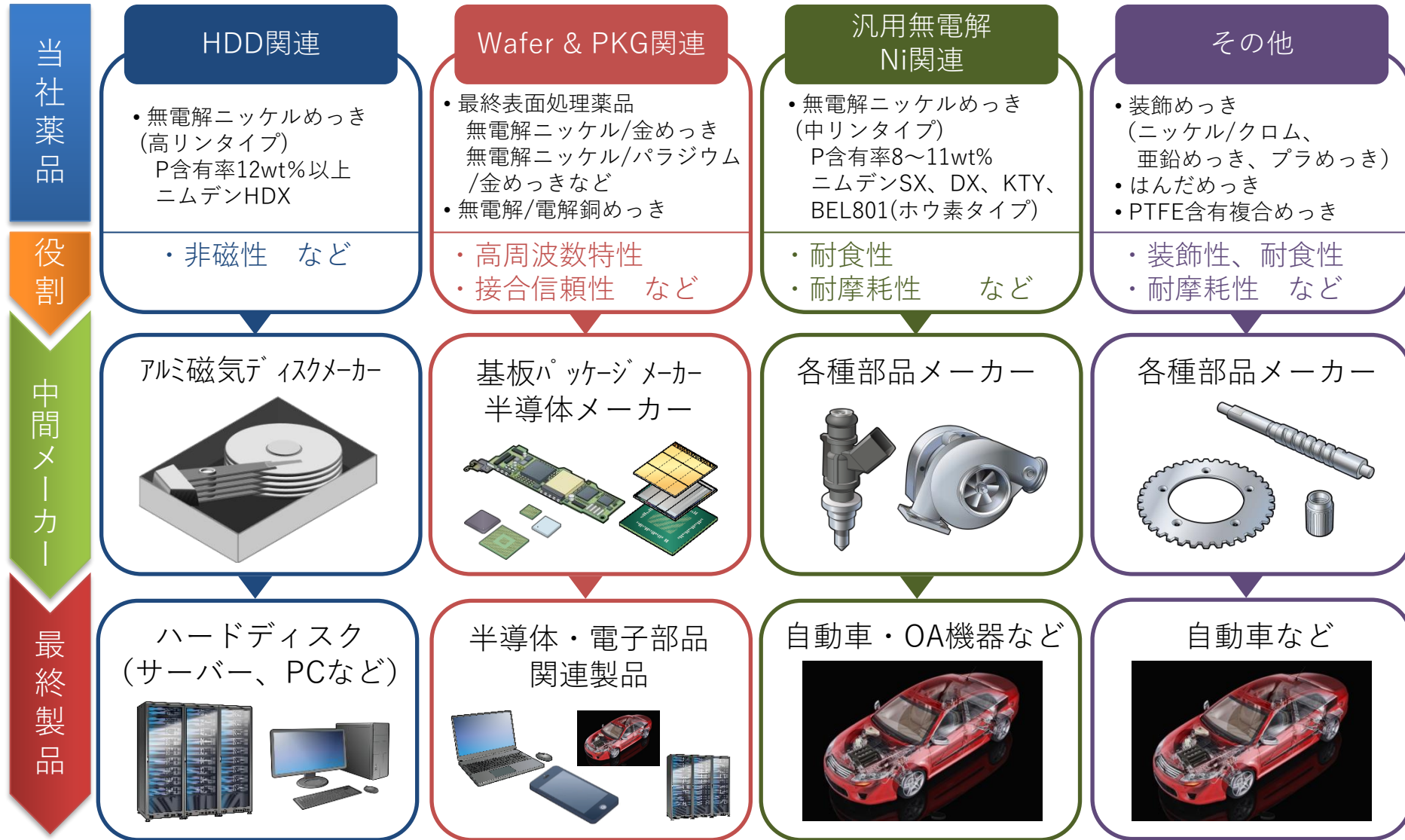
薬品カテゴリー別売上高



(単位：百万円)	前第1四半期累計実績		当第1四半期累計実績		増減額	増減率
		構成比		構成比		
HDD関連	551	4.4%	420	4.1%	△ 130	△ 23.6%
Wafer & PKG関連	9,785	77.8%	7,896	77.7%	△ 1,888	△ 19.3%
汎用無電解Ni関連	1,051	8.4%	1,257	12.4%	+ 205	+ 19.5%
薬品その他	1,192	9.5%	583	5.8%	△ 608	△ 51.0%
合計	12,580	100.0%	10,158	100.0%	△ 2,422	△ 19.3%

薬品の売上高は、表面処理用資材事業に含まれます。薬品には研磨剤、工業薬品、金属等は含んでおりません。※内部売上高含む

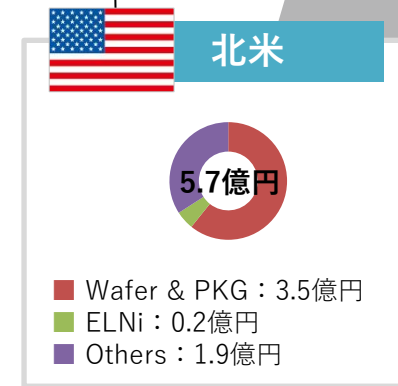
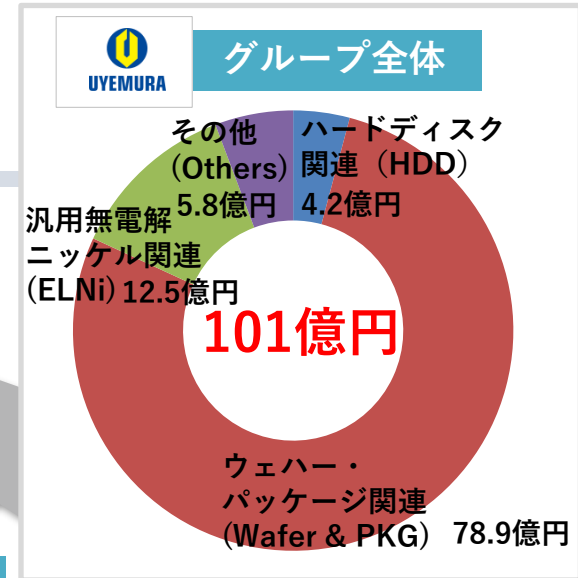
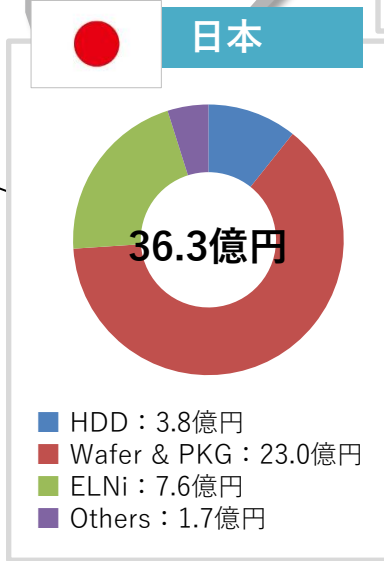
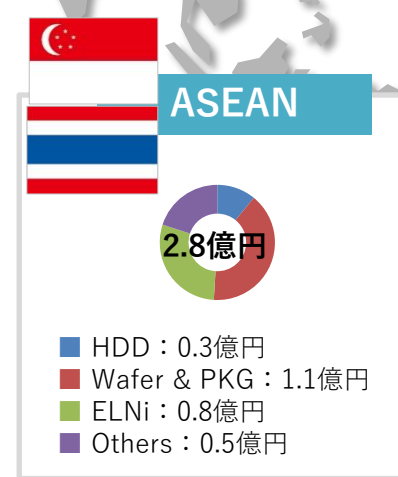
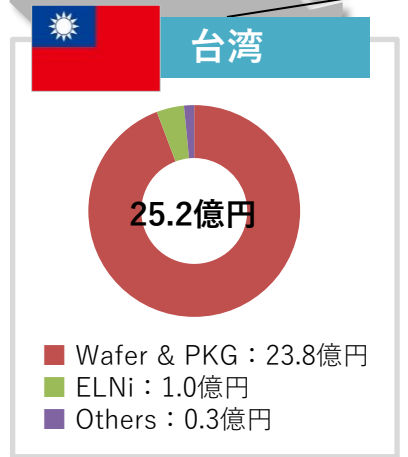
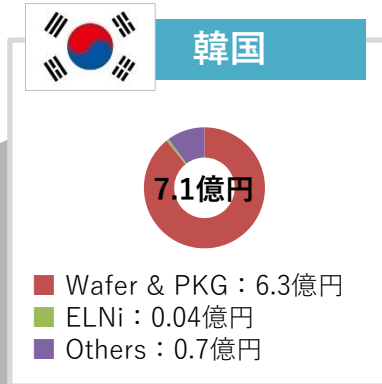
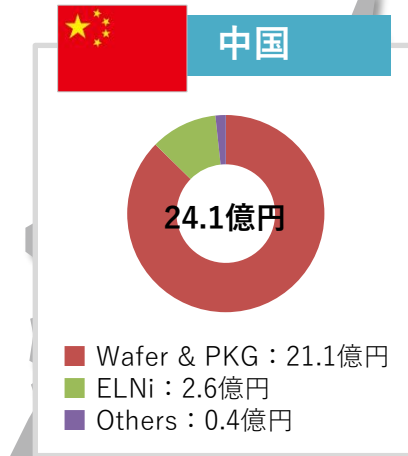
薬品ビジネス 最終製品までの流れ



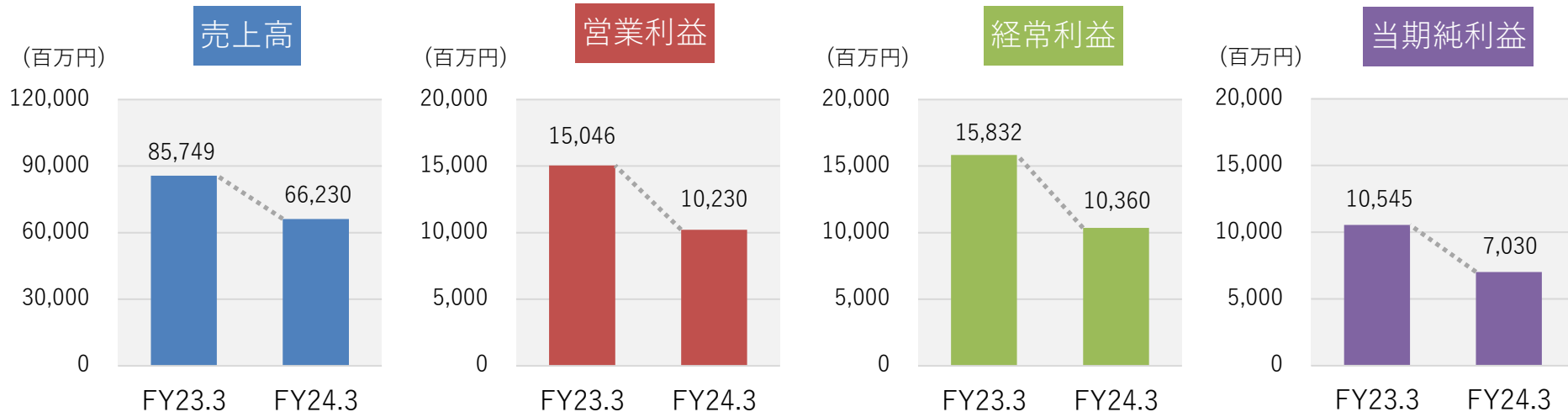
地域別薬品売上高

2024年3月期 第1四半期累計

※内部売上高含む



2024年3月期 通期業績予想



(単位：百万円)	2023年3月期 実績	2024年3月期 予想	増減額	増減率
売上高	85,749	66,230	△ 19,519	△ 22.8%
営業利益	15,046	10,230	△ 4,816	△ 32.0%
経常利益	15,832	10,360	△ 5,472	△ 34.6%
当期純利益	10,545	7,030	△ 3,515	△ 33.3%
為替：米ドル	131.62円	133.53円	1.91円安	

2024年3月期 通期業績予想

● 事業セグメント別売上高・営業利益予想

(単位：百万円)	売上高				営業利益			
	前期実績 (通期)	当期予想 (通期)	当Q1 累計実績	対予想 進捗率	前期実績 (通期)	当期予想 (通期)	当Q1 累計実績	対予想 進捗率
表面処理用資材	70,494	49,268	14,254	28.9%	13,887	8,845	2,152	24.3%
表面処理用機械	9,460	11,833	1,968	16.6%	941	1,043	185	17.7%
めっき加工	4,946	4,393	1,080	24.6%	△ 316	85	△ 38	-
不動産賃貸	844	722	205	28.4%	514	246	126	51.2%

● 薬品カテゴリー別売上高予想

(単位：百万円)	前期実績 (通期)	当期予想 (通期)	当Q1 累計実績	対予想 進捗率
HDD関連	2,329	2,100	420	20.0%
Wafer & PKG関連	39,198	29,580	7,896	26.7%
汎用無電解Ni関連	4,437	3,475	1,257	36.2%
薬品その他	4,141	3,415	583	17.1%
合計	50,107	38,570	10,158	26.3%

<参考> 為替感応度

2024年3月期想定レート：133.53円(JPY/USD)

円安に1円振れると通期で

- ・ 売上：約330百万円増
- ・ 営業利益：約30百万円増

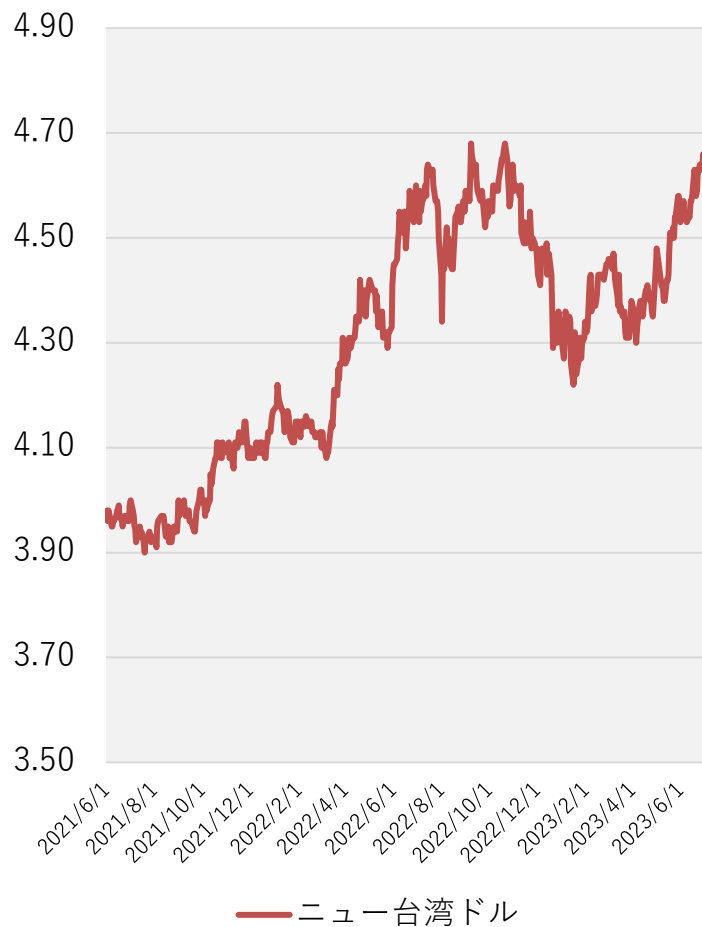
円高に1円振れると通期で

- ・ 売上：約330百万円減
- ・ 営業利益：約30百万円減

※米ドル以外の通貨も連動して動くことを想定しています。

為替レートの推移

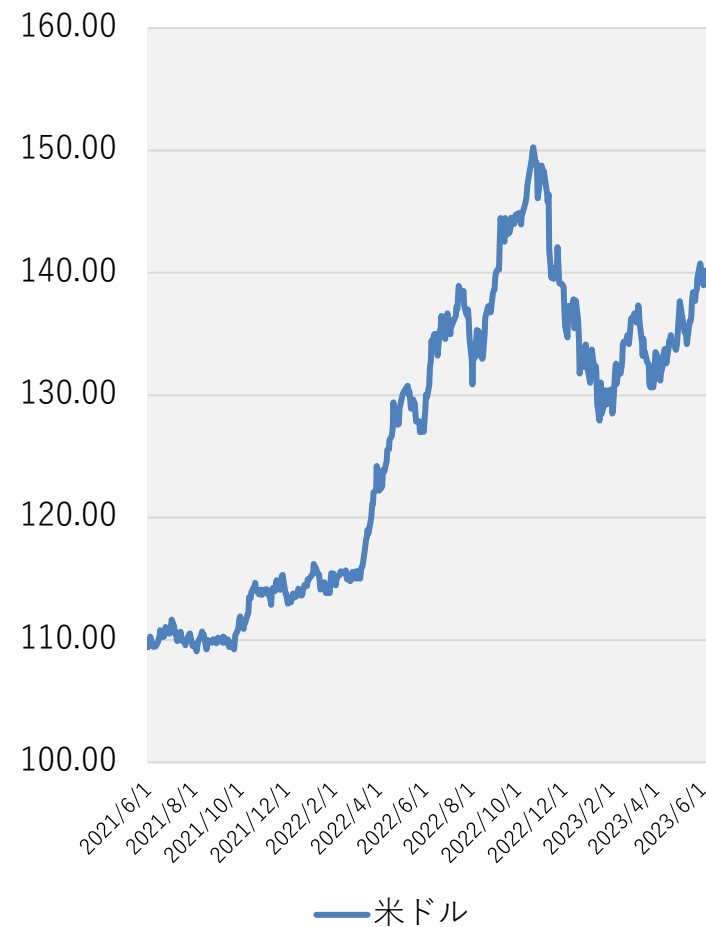
ニュー台湾ドル



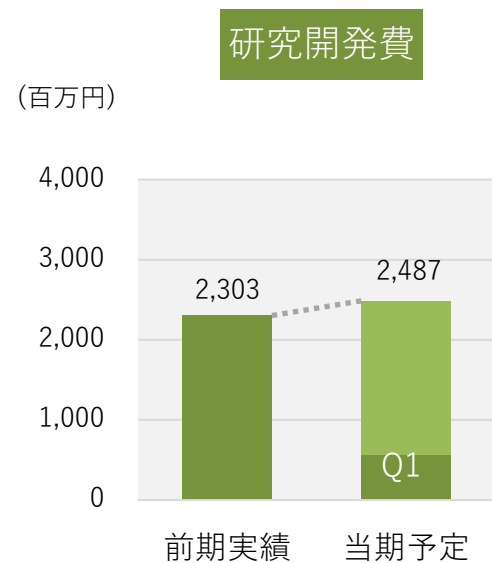
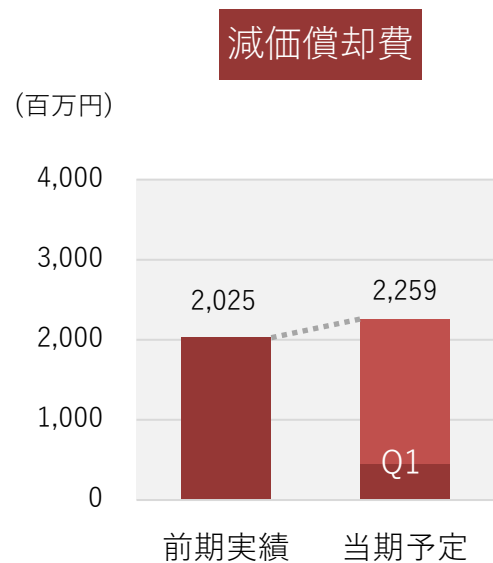
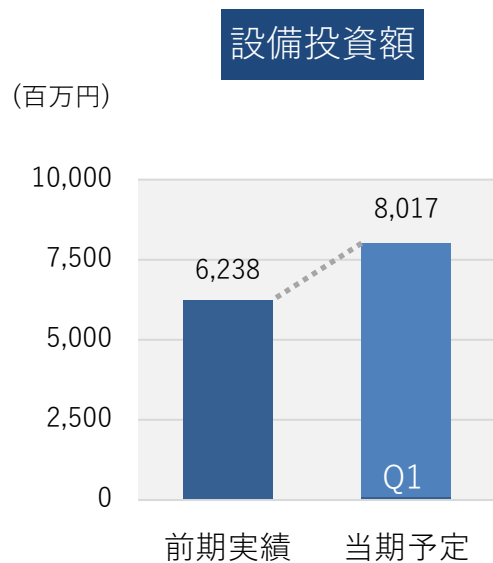
人民元



米ドル



設備投資/減価償却/研究開発費



(単位：百万円)	前期実績 (通期)	当第1四半期 累計実績	当期予定 (通期)
設備投資額	6,238	104	8,017
減価償却費	2,025	452	2,259
研究開発費	2,303	571	2,487

安定的な経営基盤の確保と株主資本利益率の向上を基本方針とした資本政策に取り組んでいます

連結総還元性向 50%、ROE 8.5%を目標

2022年3月期-2024年3月期の3年間で60億円規模の弾力的な自己株式取得を実施

中長期的にはROE 10%を目指す

- 総還元性向による安定した配当の実現と自己株式取得の機動的な実施
- 経済状況、財務状況等を総合的に勘案した弾力的な自己株式取得の実施
- 将来の成長が見込まれる分野や地域、新たな技術取得、M&A、想定外の事態や自然災害に備えた内部留保の確保

※当社は、役職員と共に持続的な企業価値創造を実現していくため、その動機付けの原資として、またM&A戦略（M&Aや業務資本提携等）を実施するため、その対価として一定の自己株式を保有します。

※M&A戦略を実施しなかった場合は、発行済株式総数の10%を超える部分については、消却いたします。

参考資料

顧客満足度向上を目指す 誠心を以って実行に徹底する

- 市場占有率が高い市場では、更に市場占有率を高めるための営業および開発戦略
- 市場占有率が低い市場では、市場占有率を上げるための営業および開発戦略
- 市場の流れに合う製造戦略
- 薬品、機械および液管理装置のトータルソリューションの提供

トータルソリューションシステム Total Solution for Plating Technologies

めっき用薬品

素材の表面に金属の薄膜を形成し、様々な機能性や装飾性を与えるための薬品

めっき用装置

大量の素材や難めっき素材に対するめっき工程を効率的に進めるための装置

液管理装置

めっき薬品の状態を常時分析し、薬液の補給を行うための装置

めっき加工

グループ会社ではウエムラ製のめっき用薬品や装置を使用しためっき加工工場を保有



▶当社は表面処理の事業分野である、めっき用薬品、めっき用装置、液管理装置の3つすべてを手掛けています。

またタイ・台湾・インドネシアのグループ会社にめっき加工の工場を保有し、ウエムラ製のめっき用薬品や装置を使用して、日々の生産を行っています。つまりめっき加工工場はウエムラ製品を扱ったモデル工場となっており、現場で実践的なノウハウを蓄積し、製品開発へのフィードバックにつなげています。

- **電子部品/半導体**

自動車関連で、電動化・自動運転が進めば多くの電子部品・半導体が使用される。全世界的に環境に対応した自動車および自動運転支援システムを搭載した環境対応自動車が増加した。環境に対応した自動車および自動運転支援システムを搭載した自動車および電動車が増加すれば、バッテリー、位置情報確認システム、支援型ナビゲーション、各種センサー、車載カメラおよびモーター制御用電子部品が飛躍的に必要になっている。レベル4の自動運転を実現するには更に多くの電子部品が必要とされている。

情報処理機器関連では、サーバーの記憶媒体にはハードディスクが使用され、サーバーと携帯端末機器間の情報伝達を制御する心臓部にも表面処理は使用されており、携帯機器およびパーソナルコンピューターに多くの表面処理が採用されている。更に自動運転支援システム等への地図情報をリアルタイムに走行中の自動車に伝達する通信を司る電子部品にも表面処理が採用されており、一時的に在庫調整はあるが需要は継続すると判断している。

- **表面処理装置**

半導体・電子部品・PKG等の部品が供給不足の為に、積極的な半導体・電子部品・PKG等の装置への設備投資が継続されており受注環境は暫く堅調。

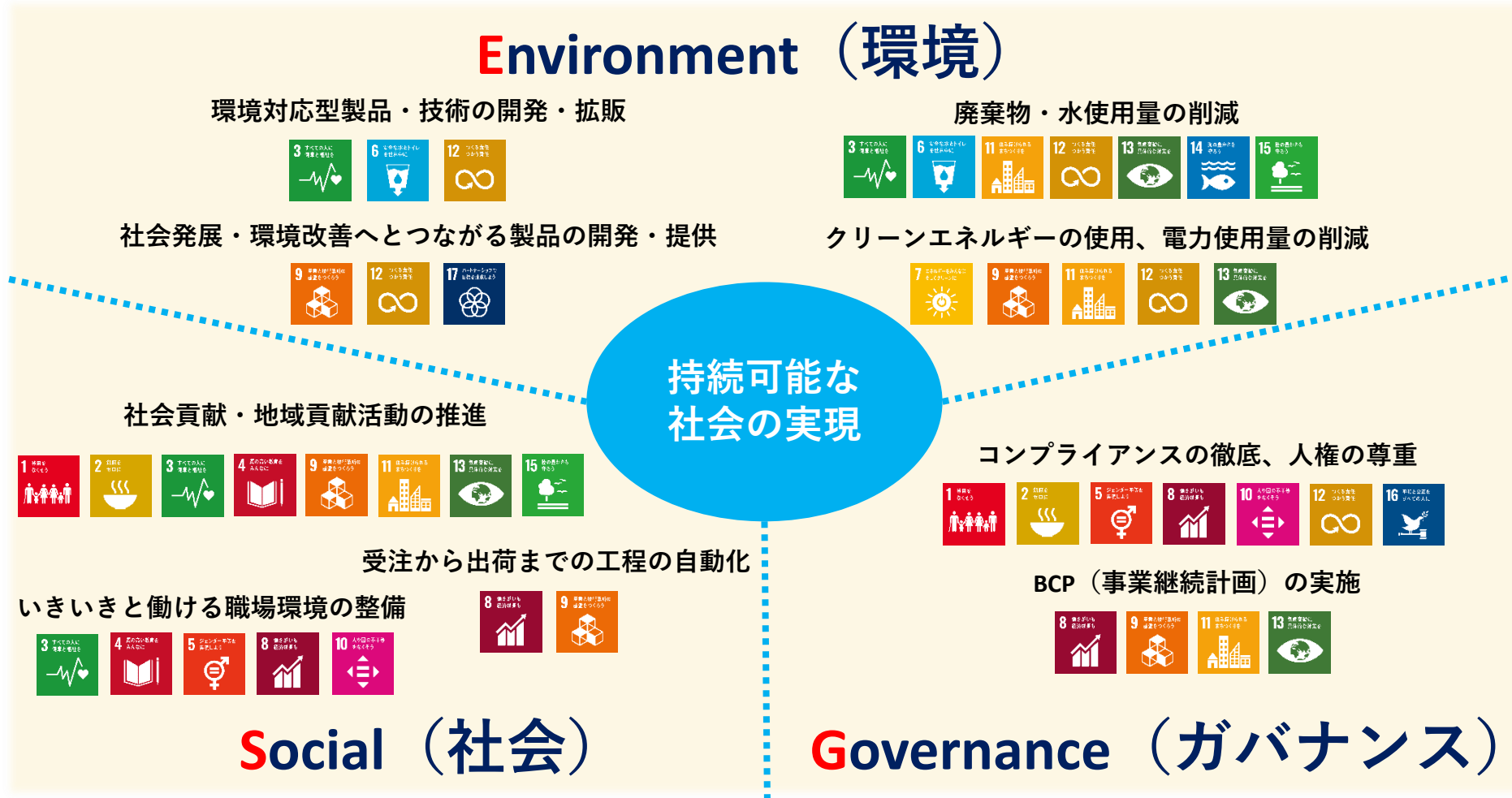
- **当社が関係する原料**

電子関連部品および機械部品不足：コロナの関係で部品製造に未だ影響があるが、部品製造状況が回復すれば、好循環になると判断している。特にdata centerの需要が、いつ回復してくるのが見えないが、EVおよびHV車向け部品の生産は好調を維持している。各社の設備投資は旺盛だが、部品の調達には問題が未だにある。













原材料の高騰および原油価格の高騰：全ての原材料および部品そして燃料はロシア・ウクライナ問題およびコロナの影響で高騰している。当然、為替の影響も大きい。自動車向け半導体素子供給に関して未だに需給が逼迫しているが回復の機運は見られる。自動車向け半導体および自動運転を補助する部品等には、表面処理薬品の大きな需要があるが、多くの薬品原料は為替等の影響で高騰しているものの、企業努力で吸収している。自社努力だけで吸収できない貴金属および金属等は、相場に連動した販売価格を設定させて頂き、お客様に理解を頂く様に日々努力している。

ESG・SDGsに関する取り組み

当社は「Growing together with  (:You)」のグループ共通スローガンのもと、ステークホルダーの皆様と共に成長・発展し、社会に貢献できる企業を目指しています



グループ会社一覧

会社名	設立年	所在地	主な事業内容
上村工業株式会社	1848年(創業) 1933年(設立)	日本	    
株式会社サミックス	1963年	日本	
ウエムラ・インターナショナル・コーポレーション	1985年	米国	  
上村(香港)有限公司	1986年	中国 (香港)	
台湾上村股份有限公司	1987年	台湾	    
サムハイテックス	1987年	タイ	   
上村工業(深圳)有限公司	1988年	中国 (深圳)	   
ウエムラ・インターナショナル・シンガポール	1992年	シンガポール	
ウエムラ・マレーシア	1996年	マレーシア	 
上村化学(上海)有限公司	2002年	中国 (上海)	
韓国上村株式会社	2010年	韓国	 
ウエムラ・インドネシア	2012年	インドネシア	 



営業



研究開発



薬品製造



機械製造



めっき加工



不動産賃貸

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

Growing together with



Uyemura Group Companies

- | | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| • Japan | C.Uyemura & Co., Ltd.
Sumix Corporation | • Taiwan | Taiwan Uyemura Co., Ltd. |
| • USA | Uyemura International Corporation | • Korea | Uyemura Korea Co., Ltd. |
| • Hong Kong | Uyemura International (Hong Kong) Co., Ltd. | • Singapore | Uyemura International (Singapore) Pte Ltd |
| • Shenzhen | Uyemura (Shenzhen) Co., Ltd. | • Malaysia | Uyemura (Malaysia) Sdn. Bhd. |
| • Shanghai | Uyemura (Shanghai) Co., Ltd. | • Thailand | Sum Hitechs Co., Ltd. |
| | | • Indonesia | PT. Uyemura Indonesia |